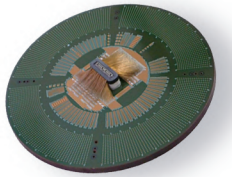
JINGCE ELECTRONIC 精测电子

半导体探针卡系列

Semiconductor Probe Card Product Series

悬臂探针卡



产品用途

用于Logic、DDI、CIS、Memory、IGBT类等芯片的CP高效测试。

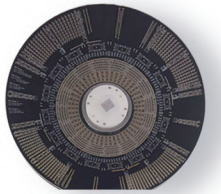
测试机型号 Advantest（93k/T6373/T6391/T5830）、Teradyne（J750HD等）

产品特点

高密度布置 可对应高针数	支持 多DUT测试	支持狭窄间距 的芯片测试	交期短 成本低

产品参数					
探针规格	≥3mil 材质：P7/ReW	使用寿命	ReW：100+万次 P7：600+万次	温度	-40~150°C
针尖位置精度	±3um	频率	<1.8GHz		
针尖水平	<10um	最小pitch	22um		

Cobra 垂直探针卡



产品用途

用于SOC、Logic 、MCU等芯片的CP高效测试。

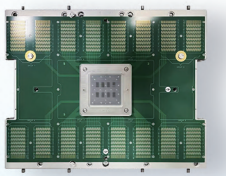
测试机型号 Advantest（93K/93KDD）、Teradyne（J750HD等）

产品特点

采用圆形 Cobra针	高密度布置 中低针数	支持 多DUT测试	最小 Pitch 80um	测试寿命 可达80万次

产品参数					
探针规格	≥2mil	针尖水平	<20um	温度	-55~150°C
空间转换组件	WST/MLO/MLC	使用寿命	>80万次	C.C.C	0.5~1A
针尖位置精度	±10um	最小pitch	80um		

2D MEMS垂直探针卡



产品用途

用于SOC、Logic、MCU等芯片的CP高效测试。

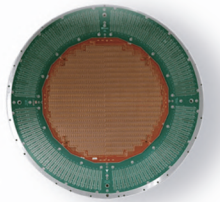
测试机型号 Advantest（93K/93KDD）、Teradyne（J750HD等）

产品特点

自研 MEMS方针	高密度 布置高针数	支持 多DUT测试	最小 Pitch 70um	测试寿命 可达100万

产品参数					
探针规格	MS60 / MS45	针尖水平	<20um	温度	-55~150°C
空间转换组件	WST/MLO/MLC	使用寿命	>100万次	C.C.C	0.5~1.2A
针尖位置精度	±10um	最小pitch	70um		

2.5D MEMS探针卡



产品用途

用于Memory、CIS等芯片的CP高效测试。

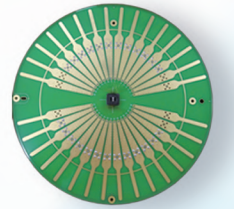
测试机型号 Advantest（T5830/T5833等）

产品特点

自研 2.5D MEMS针	高密度 布置高针数	支持 One Touch测试	高低温 测试	测试寿命 可达30万次

产品参数					
探针规格	2.5D MS50 / MS35	针尖水平	<15um	温度	-40~125°C
针尖大小	8*8um~10*10um	使用寿命	>30万次		
针尖位置精度	±3um	最小pitch	50um		

WAT 探针卡



产品用途

用于芯片制造过程电性检测。

测试机型号 Keithley（S400/S600/S900）、Agilent（4071/4072/4062）Keysight（4070/4080）

产品特点

采用 ReW/P7探针	超低漏电	测试寿命 可达100+万次	交期短 成本低

产品参数					
探针规格	ReW / P7	使用寿命	>100万次	温度	-40~150°C
针尖位置精度	±3um	最小pitch	30um		
针尖水平	<5um	漏电	0.5pA@10V		

关注精测
了解更多

服务支持，敬请联系：027-87002120 | mkt@jcdz.cc